

Schadensanalytik – Klima- und Kriechstromschäden bei Hochvolt- und Signalelektronik

Referenten

Dr. Markus Meier 09.00 // Begrüßung

Gruppenleiter Reliability &
Surfaces

ZESTRON Europe

- Firmenpräsentation und Vorstellung des Tagesprogramms
- Vorstellungsrunde und spezifischer Fokus der Teilnehmer

Dr. Markus Meier 09.30 // Einführung

- Notwendigkeit der Schadensanalyse
- Feuchte-materialinduzierte Ausfallmechanismen in der Leistungselektronik
- Kurzvorstellung des analytischen Handwerkszeugs

10.30 // Pause

David Dudek 11.00 // Schadensanalytik elektronischer Baugruppen

Projekt- und
Zuverlässigkeitsingenieur
Trainalytics GmbH

- Fehler verstehen – Vom Erfassen der Fehleranamnese bis zur detaillierten Schadbildanalyse
- Ursachen finden – Hypothesen entwickeln, prüfen und verifizieren
- Lösungen sichern – Maßnahmen ableiten und Qualität nachhaltig stärken

11.45 // Mittagspause

Stefan Schmitt

Director Product Compliance
Semikron Danfoss Elektronik
GmbH & Co. KG

12.45 // Klimasicheres Design elektrischer und elektronischer Baugruppen –

Praktische Tipps

- Häufige Fehler bei der Durchführung von Klimatests
- Methodische Schwachstellen- und Ausfallanalyse

14.00 // Pause

Teilnehmerunter Anleitung 14.15 // Praktische Übung: Bearbeitung eines Schadensfalles

- Systematische Vorgehensweise bei der Analyse
- Bearbeitung eines Schadensfalles in Arbeitsgruppen

Dr. Markus Meier 15.30 // Abschlussdiskussion

- Diskussion der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen
- Ggf. Diskussion von Problemstellungen der Teilnehmer

16.00 // Ende der Veranstaltung